

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年11月20日)

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他 _____</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>在线参与公司2024年第三季度业绩说明会的投资者 CHINA ALPHA FUND MANAGEMENT (HK) LIMITED STEVEN TENG、 CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT LINGHAO ZHU、KHAZANAH NASIONAL BERHAD EDRYNA ZAHARANI、M&G INVESTMENT MANAGEMENT MICHAEL BOURKE、SPRINGS CAPITAL SEAN FENG、 UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT HAIMING WANG、JPMORGAN BILLY FENG、JPMORGAN CHERRY LIU、JPMORGAN RAE XU、 JPMORGAN ANQI WEI</p>
<p>会议时间</p>	<p>2024年11月20日 10:00-11:30 2024年11月20日 11:30-13:00</p>
<p>会议地点</p>	<p>上证路演中心、佰维存储三楼会议室</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 孙成思 总经理 何瀚 董事会秘书 黄炎烽 战略部总监兼投资者关系负责人 肖博天 董办工作人员</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>Q1. 请问公司今年三季度业绩增长有哪些原因？ A1: 2024年前三季度公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，公司营业总收入同比增长 136.76%；同时，产品价格同比回升，公司前三季度综合毛利率同比增长 25.99 个百分点，其中第三季度营业收入同比增长 62.64%。</p> <p>Q2. 请问贵公司的募集资金计划非公开增发 6469 万股是已经增发完成了，还是还在推进中？ A2: 公司定增正常推进中，后续进展请关注公司披露的相关公告。</p> <p>Q3. 请问公司对存储行业未来几年的发展研判是怎样的？ A3: 下一代信息技术与存储器技术发展密不可分。物联网、大数据、人工智能、智能车联网、元宇宙等新一代信息技术既是数据的需求者，也是数据的产生者。同时，AI 技术革命将大大提升对高端存储器的需求。据全球知名市场研究机构 Yole 发布的报告显示，得益于数据中心、云计算和 5G 等行业的持续增长以及全球半导体供应链的逐步恢复，2027 年存储市场空间预计增长至 2,630 亿美元。目前存储器国产化率较低，存储芯片的国产化率将随着市场和政策的双向推动</p>

	<p>大幅提升，国产存储产业前景广大。</p> <p>Q4. 今年已经进入到第四季度，请问上游存储芯片的价格自第三季度以来，有什么样的变化？预计明年原厂的存储芯片价格走势如何？</p> <p>A4: 2024年三季度以来，存储产品价格有所回落。行业库存主要在中下游环节，下游客户三季度放缓了提货节奏，在控制和消化库存水位。从下游需求看，四季度市场需求比三季度有所恢复，主要驱动因素是客户库存消化和传统消费电子旺季；明年一季度目前没有看到大的需求变化，需要进一步观察头部厂商如苹果、OPPO、小米、VIVO、荣耀等 AI 产品迭代，另一方面看存储结构性机会，例如 PCIe Gen5、DDR5、LPDDR5、QLC 等新产品、新技术的替代趋势等。针对这些机会，公司也有相应的布局，在客户方面，公司已经进入国内外一线手机和穿戴客户，在适配多模态应用的 AR 眼镜上与 Meta 深入合作；DDR5 产品在电商平台销售名列前茅；在产品方面，公司是国内少数同时拥有大容量 eMMC、UFS 和 LPDDR 产品的存储器厂商，并已布局 PCIe Gen5 产品，迎合 AI 应用驱动存储升级的趋势，同时，公司推出了支持 QLC 颗粒的存储主控芯片，迎合手机存储 QLC 替代趋势。</p> <p>Q5. 今年第三季度毛利率环比下滑，请问原因是什么呢？Q2 的业绩高速增长主要受真实的需求恢复增长驱动，还是下游备货增加影响呢？预计第四季度跟明年一季度，毛利率是否还有改善空间？</p> <p>A5: 公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响。随着库存结构的更新，公司毛利率会逐渐回归到中枢水平。从长期来看，存储市场国产化率较低，国产化率的提升为公司营收增长提供了广阔的空间。公司持续加强研发投入，新产品的开发和技术能力的提升进一步助推公司营收和利润的增长，全球化的布局和自有品牌建设也将提升公司长期的营收和盈利水平。</p> <p>Q6. 请问公司主营方面未来有什么战略性的计划？</p> <p>A6: 公司将进一步强化研发封测一体化布局，在存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节不断突破，服务产业发展新趋势，贡献更大价值。同时，公司将持续坚持“5+2+X”的发展战略，在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作；在智能穿戴和工车规市场投入战略性资源，力争成为主要参与者；持续布局芯片设计和晶圆级先进封测，打造公司二次增长曲线；对存算一体、新接口、新介质和先进测试设备等创新领域进行探索与开拓。通过以上战略布局，兼顾公司短/中/长期发展目标，推动公司持续构建新质生产力，提升公司的价值和股东回报。</p> <p>Q7 请问对于目前行业下游需求复苏不及预期、上游原材料持续涨价的现状怎么看？公司有什么应对措施？</p> <p>A7: 2024年三季度以来，存储产品价格有所回落。行业库存主要在中下游环节，下游客户三季度放缓了提货节奏，在控制和消化库存水位。从下游需求看，四季度市场需求比三季度有所恢复，主要驱动因素是客户库存消化和传统消费电子旺季。公司在品牌、技术、研发封测一体化构建和资本等方面均具备先发优</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>势，将牢牢把握未来的产业发展趋势，持续构建品牌、规模和技术壁垒。</p> <p>Q8. 公司在东莞的晶圆级先进封装项目，在定增募集资金到位前，计划以自筹资金先行投入，请问该项目的最新建设进展如何？投产日期预计何时？</p> <p>A8: 公司的晶圆级先进封测制造项目尚处于前期投入阶段，正在建设中，预计将于 2025 年投产，为客户提供整套的存储+先进封装测试解决方案。</p> <p>Q9. 公司未来一到两年在对外的投资并购方面，有哪些思考或具体计划？</p> <p>A9: 公司坚持围绕主业，持续做好经营管理，努力提升研发水平和业务能力，同时积极关注存储产业链相关的整合机会，如有投资并购计划，公司将严格按照监管部门的相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的公平、及时、准确、真实和完整。</p> <p>Q10. 公司研发投入持续在加大，请问公司目前或者未来是否有技术上的重大突破？</p> <p>A10: 公司持续加大芯片设计、解决方案研发、先进封测及存储测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才。在芯片设计领域，公司首颗主控芯片 SP1800 实现多项国产突破，性能优异，目前已与国内某头部客户进行产品验证，进展顺利；同时，适配 QLC 大容量存储和车规的主控产品也在开发中。在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区，预计将于 2025 年投产，为客户提供整套的存储+先进封装测试解决方案。在测试设备领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。在企业级领域，公司发布的 CXL 2.0 DRAM 采用 EDSFF (E3.S) 外形规格，可与支持 CXL 规范及 E3.S 接口的背板和服务器主板直连，扩展服务器内存容量和带宽。</p> <p>Q11. 公司公告称 11 月 26 日将有限限售股上市流通，请问对公司有什么影响？</p> <p>A11: 2024 年 11 月 26 日公司部分首发限售股份将上市流通，本次解禁 840,000 股。公司将持续通过多方面举措改善公司经营情况，不断提升内在价值，以规范运作为基础，推动公司高质量可持续发展，努力回报广大投资者，提高长期投资者的持股信心。</p> <p>Q12. 公司坚持研发封测一体化的经营模式，目前是否利用多余的产能进行外部产品加工？</p> <p>A12: 公司以子公司泰来科技（惠州佰维封测制造基地）作为先进封测及存储器制造基地。泰来科技专精于存储器封测及 SiP 封测，目前主要服务于母公司的封测需求。未来，随着产能不断扩充，泰来科技将利用富余产能向存储器厂商、IC 设计公司、晶圆制造厂商提供代工服务，形成新的业务增长点。</p> <p>Q13. 公司与 Meta 在智能眼镜产品的合作情况是怎样的？后续是否还有持续合作？公司是否又拓展其他可穿戴产品客户？</p> <p>A13: 公司为 Ray-Ban Meta 提供 ROM+RAM 存储器芯片，是国内的主力供应商。根据第三方机构的拆机报告，公司提供的存储器产品是 Meta 眼镜中价值量仅次于 SOC 的第二大电子元件。当前公司与 Meta 合作稳定，订单量持续增长。基于</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>公司研发封测一体化的布局，公司存储器产品在智能可穿戴领域具有较强的竞争优势，能够在低功耗、快响应等方面进行固件算法优化设计的同时，通过先进封测工艺能力，助力产品的轻薄小巧。此外，公司自研主控也将进一步增强公司产品在穿戴领域的竞争力，目前已通过了某头部客户的初步选型，比较优势得到客户认可。公司在智能穿戴领域目前已进入 Google、Meta、小米、小天才等知名企业，产品应用于其智能手表、智能眼镜等。未来，公司将在智能穿戴市场持续投入战略性资源，力争成为主要参与者。</p> <p>Q14. 在智能汽车领域，公司目前有哪些产品布局？公司在汽车存储有什么发展规划？</p> <p>A14: 基于公司研发封测一体化的布局，公司在存储介质特性、主控 IC 设计、硬件设计与仿真、固件算法开发、先进封测等环节积累了深厚的技术优势，公司推出了涵盖 eMMC、UFS、SPI NOR、LPDDR、BGA SSD、存储卡在内的全面车规存储产品矩阵，系列产品支持-40℃~105℃宽温工作环境，并满足 AEC-Q100 车规级可靠性标准，覆盖多种容量等级，为智能汽车客户提供高可靠、高稳定的一站式数据存储选择。公司车规存储相关产品已在国内头部车企及 Tier1 客户量产。公司面向汽车电子应用与工业场景打造了子品牌“佰维特存”，为汽车与工业领域的客户带来高附加值的存储解决方案。未来，公司将不断推出更多贴合市场需求、性能卓越、高品质的车规存储产品，提升市占率，力争成为车规存储市场主要参与者。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 11 月 20 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。